

サーマルマネジメント標準化検討G

◆ 目的・スコープ

- 電子部品の放熱形態は、リード付き部品のように大気への放熱を主としたものから、表面実装部品のように基板への放熱を主としたものに変化している。しかしながら、規格を含め、このような基板放熱主体の部品に対する熱設計のためのインフラストラクチャーが不足している。そのピックアップと整備を行う。

◆ 活動の概要

- 以下の3つのサブグループ（SG）に分かれて、2019年度技術レポート発行を目指して活動中。
- 部品使用環境温度規定SG：基板放熱主体の部品に関して、部品の放熱経路に基づいた、あるべき使用環境温度の規定方法を検討する。
- 基板放熱ガイドライン検討SG：基板放熱を積極的に利用した熱設計手法を検討する。
- 温度測定SG：基板放熱主体の部品は一般的にサイズが小さく、従来の温度測定の常識が通用しない。微小部品の温度測定ガイドラインを策定する。